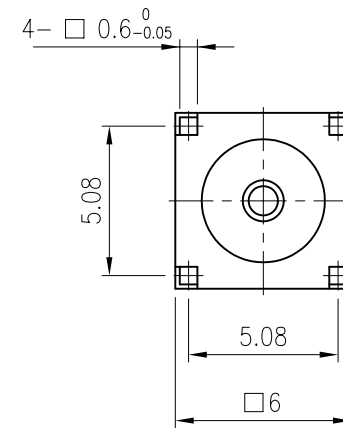
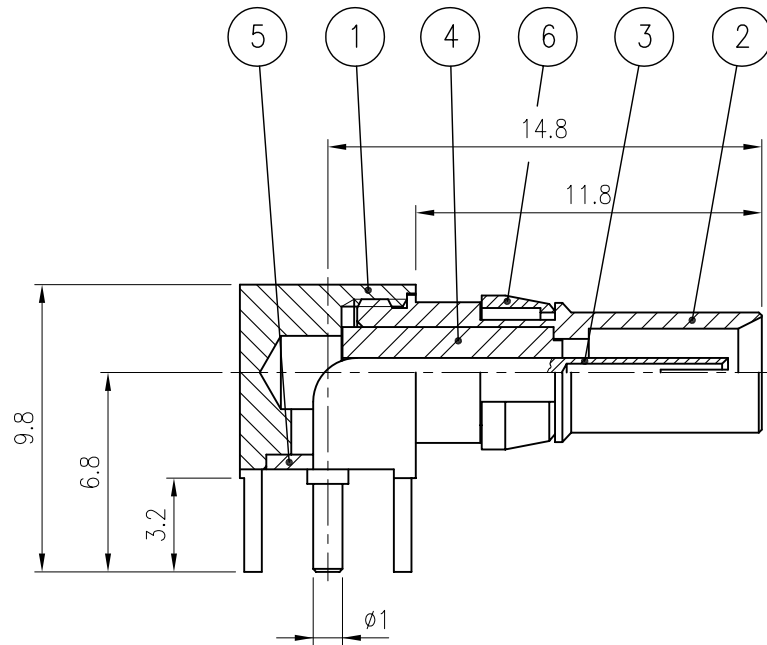


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
가공														
ST(기준)														
ST(개선)														



6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00853-N/1 (HB045)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN0860-N/1 (HB044)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00913-1345/1 (EB031)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01155-135/1 (DB064)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01149-135/1 (DB063)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		1997. 7. 6.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	재질	검도			도명 CONNECTOR		
	채도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 CN00629-7/1	
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	총량			K385-605-000	